

证券代码：831756

证券简称：德高化成

主办券商：华福证券

天津德高化成新材料股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

天津德高化成新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津德高化成科技有限公司(以下简称“德高科技”)经营需要,向北京银行股份有限公司天津分行申请单笔授信人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00),业务品种为固定资产贷款,业务期限5年,用于“第三代半导体 GaN 倒装芯片 LED 封装制造扩产项目”建设。由德高科技名下坐落于“开发区第六大街以南、微山路以东”的项目土地及在建工程抵押,待符合条件后,及时办妥本项目房地产抵押。同时公司和实控人谭晓华先生为支持德高科技的发展决定为上述银行贷款提供连带责任保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025年7月8日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款授信暨关联交易的议案》,表决结果为同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事谭晓华先生回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：天津德高化成科技有限公司

成立日期：2018 年 8 月 27 日

住所：天津经济技术开发区第六大街以南，微山路以东区域西北角

注册地址：天津经济技术开发区第六大街以南，微山路以东区域西北角

注册资本：30,000,000 元

主营业务：高分子复合材料系列产品、电子元器件及半导体材料的采购、研发、销售及相关产品的技术咨询、技术服务；劳务服务；机械设备、金属材料、胶制品及材料的销售、货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：谭晓华

控股股东：天津德高化成新材料股份有限公司

实际控制人：谭晓华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人系天津德高化成新材料股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 5 月 31 日资产总额：11,459,616.48 元

2025 年 5 月 31 日流动负债总额：3,870,577.76 元

2025 年 5 月 31 日净资产：7,589,038.72 元

2025 年 5 月 31 日资产负债率：33.78%

2025 年 5 月 31 日资产负债率：33.78%

2024 年营业收入：8,961,993.18 元

2024 年利润总额：299,482.30 元

2024 年净利润：310,399.99 元

审计情况：2025 年 5 月 31 日数据未经审计，2024 年度数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司和实控人谭晓华先生为支持全资子公司德高科技的发展，决定为德高科技拟向北京银行股份有限公司天津分行申请叁仟万元整（¥30,000,000.00）人民币的贷款授信额度提供连带责任保证担保。具体授信品种、金额、利率、期限等以与银行签订的贷款合同及担保合同为准，并按银行贷款要求出具相关文件。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司和实控人谭晓华先生为支持全资子公司德高科技的发展，决定为德高科技拟向北京银行股份有限公司天津分行申请叁仟万元整（¥30,000,000.00）人民币的贷款授信额度提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司对德高科技拥有 100%控制权，其财务风险处于可控的范围之内。因此 上述担保不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

本次德高科技向银行申请贷款是为满足生产经营发展和对资金的实际需要， 不会对公司经营产生不利影响，不存在损害股东利益情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	15.34%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件

《公司第四届董事会第十二次会议决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日